

新製品

Ultrasonic Cutting System

TAKADA

両端支持構造による高い剛性

超音波アシストが生む高品質切断

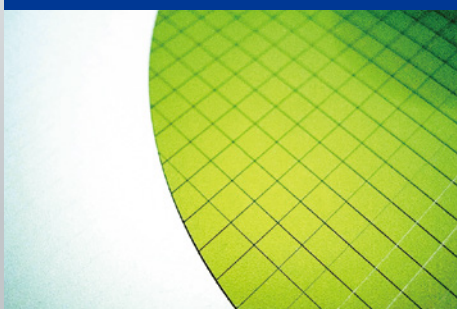
超音波カッティング装置 CSX501



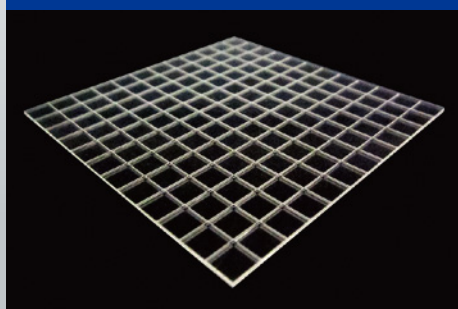
ブレードダイシングの限界を超え、次世代材料切断へ挑戦する

難削材 **VS** 超音波アシスト切断

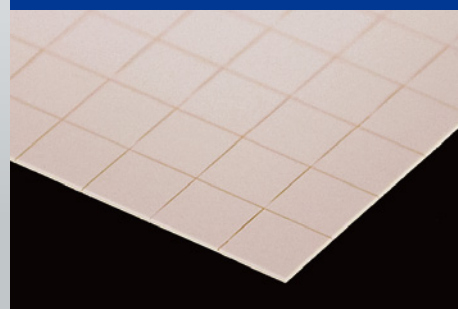
次世代パワーデバイス



強化ディスプレイ



次世代高周波デバイス

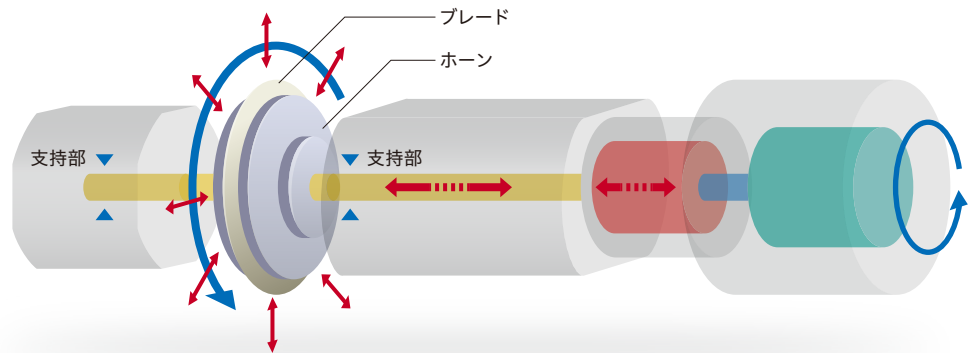


超音波カッティングとは

超音波カッティング装置
CSX501

Ultrasonic
Cutting
System

回転砥石による切断 + 超音波アシストにより
切断負荷とブレード摩耗の低減を実現



TAKADA独自の両端支持構造により、
超音波振動を効率的にブレードへ伝達し、高精度な高速切断を実現

装置概要

生産性の向上

- ▶搬送ラインを最適化、搬送タクトを30%短縮(当社比)
- ▶ブレード破損検知機能を改善し、切断動作時間を短縮

切断バリ除去機能

- ▶切断対象に残っているバリを除去することが可能

※ワークによって効果が得られない場合があります



遠隔装置状態監視機能

- ▶装置状態を遠隔監視(オプション)をすることで不測のトラブル時に原因究明の手助けをし、平均復旧時間を短縮



省フットプリントの実現

- ▶装置横幅を20%縮小(当社比)

最大ワークサイズ	Φ200mm
最大フレーム	6,8インチリング
X軸	切断可能範囲 220mm 最大切断速度 500mm/s
Y軸	切削可能範囲 220mm 最高速度 500mm/s
Z軸	ストローク 129.5mm
装置寸法	1,200mm ^(W) × 1,320mm ^(D) × 1,850mm ^(H)
装置重量	約2,500kg

TAKADA

問い合わせ先
株式会社 高田工業所
装置事業部

〒806-8567
福岡県北九州市八幡西区築地町2-1

TEL 093-632-2600

<https://www.takada.co.jp/jigyo/usw/>



切断材料 ▶ SiC、PZT、AlN、水晶、石英、樹脂など各種基板材料のダイシング

無償切断評価を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。